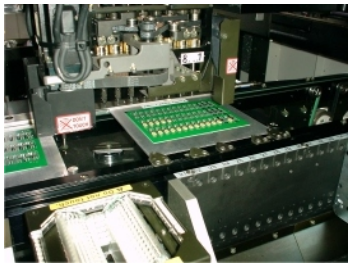
SMD

TECHNOLOGIE / TOUS PRODUITS AVEC OU *SANS PLOMB (ROHS)*

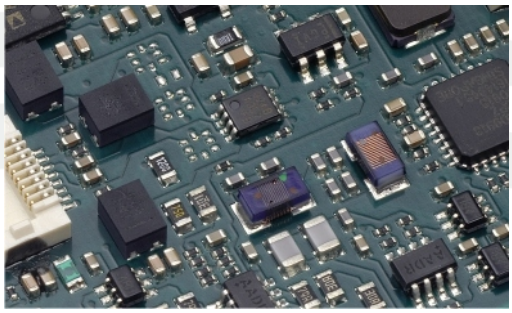
SUBSTRATS

CÉRAMIQUE COUCHE ÉPAISSE
FR4, FR5, G10, G11, ROGERS
FLEX, FLEX RIGIDE, IMS
PYREX
...



DÉPOSE DE PÂTE À SOUDER

SÉRIGRAPHIE AVEC MASQUE OU ÉCRAN
DISPENSING, POINT PAR POINT.



POSE DE COMPOSANTS

JUSQU'À 20'000 COMPOSANTS/HEURE
PRÉCISION DE PLACEMENT À +/- 50µm

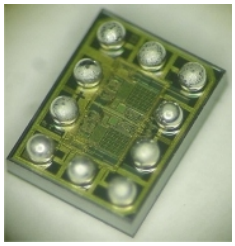
HYBRID SA EST À MÊME DE RÉALISER LE MONTAGE DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES EN SURFACE SUR DES SUBSTRATS SIMPLES OU DOUBLES FACES. LES RÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE NORMES SONT:

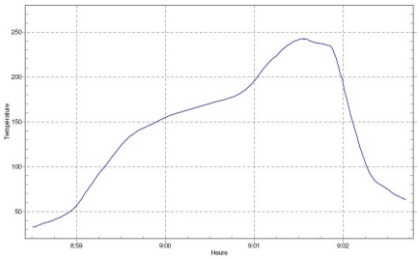
IPC/JEDEC J-STD-020D ET IPC-A-610 LA CLASSE 3 EST APPLIQUÉE EN STANDARD.

TYPE DE COMPOSANTS

BOÎTIER STANDARDS, DÈS "0201"
IC STANDARDS ET TYPES PLCC, QFN, BGA, CSP,
FLIP-CHIP, SOLDER BUMP.

COMPOSANTS EXOTIQUES
TRANSFOS, SELFS, RESSORTS CONIQUES, QUARTZ,
CONTACTS BATTERIE ETC...





REFLOW

FOUR À CONVECTION AVEC CONVOYEUR À BANDE

LAVAGE

SYSTÈME DE LAVAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
LAVAGE PHASE VAPEUR

HYBRID SA CH-2025 Chez-le-Bart Tel.: ++41 (0)32 835 33 88 E-mail: mailbox@hybrid.swiss https://www.hybrid.swiss